

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司

关于签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、合同概况

1、基本情况

深圳市博远高科股份有限公司（以下简称“公司”）与西畴县人民政府、深圳市中鑫泰投资发展有限公司签署了《西畴县半导体产业园芯片封测项目投资合作协议》，项目估算投资 1.5 亿元，项目建设内容为：建设芯片封测生产线及配套相关设施设备。

2、审议和表决情况

上述合同为合作意向协议，签订三方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，上述合同签订事项需要通过董事会及股东大会审议。

二、合同相对方的情况

1、西畴县人民政府

名称：西畴县人民政府

地址：西畴县人民路 31 号

2、深圳市中鑫泰投资发展有限公司

名称：深圳市中鑫泰投资发展有限公司

地址：深圳市宝安区航城街道深业 U 中心 B 栋

经营范围：投资兴办实业、投资管理、投资咨询（以上）；物业管理

三、合同对挂牌公司的影响

1、上述合同的签订符合公司战略发展需要，对公司业务发展和市场开拓具

有重要意义，对公司的经营业绩将带来积极影响。合同的按约履行将进一步提升公司主营业务在市场的竞争地位，扩大公司业务规模，提高公司盈利能力，增强公司核心竞争力。

2、上述合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主营业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖的情形。

四、合同履行风险提示

公司将积极组织、协调及有效管理好相关资源，保证合同的实施执行，但是上述合同履行过程中可能遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，导致合同无法全部履行完毕或终止的风险，敬请投资者注意风险。

五、备查文件目录

- （一）《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《西畴县半导体产业园芯片封测项目投资合作协议》

深圳市博远高科股份有限公司

董事会

2023年6月16日